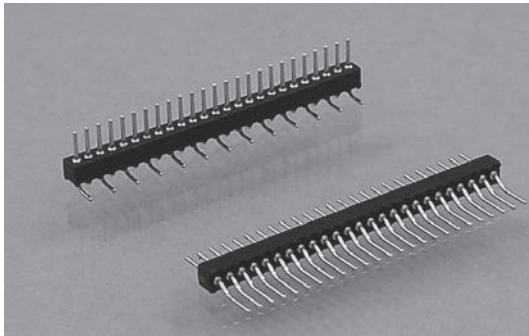


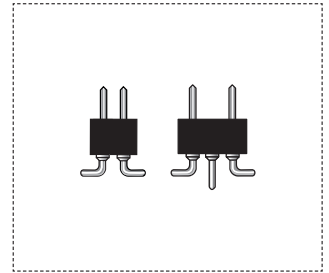
(寸法単位:mm)



超ミニチュアPCBピンコネクタ  
表面実装用ハンダ付タイプ

**仕様**

接続側ピン径:  $\varnothing 0.41\text{mm}$   
 機械的寿命: 500回(最低)  
 定格電流: 1A  
 耐電圧: 1,000Vrms(最低)  
 SMDコプラナリティー: 0.1mm(最大)



適合レセプタクルシリーズ  
R851/R853/R855



任意のピン数に  
カット出来ません。

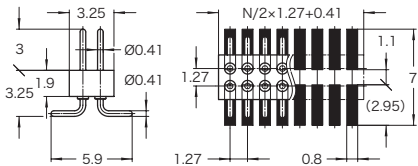
標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

**R852...30-001シリーズ**

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列  
ピン数 4~100 標準ピン数 50、100

メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	50ピン	100ピン	任意のピン数 <sup>**</sup>
0.25 $\mu\text{m}$ 金	R852-10-050-30-001	R852-10-100-30-001	R852-10-xxx-30-001
純錫	R852-80-050-30-001	R852-80-100-30-001	R852-80-xxx-30-001



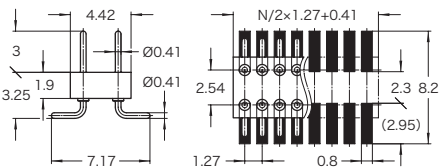
■ハーフピッチの表面実装ダブル・インライン・ピンコネクタで、基板に対し垂直に実装されます ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

**R852...30-002シリーズ**

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列  
ピン数 4~100 標準ピン数 100

メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	—	100ピン	任意のピン数 <sup>**</sup>
0.25 $\mu\text{m}$ 金	—	R852-10-100-30-002	R852-10-xxx-30-002
純錫	—	R852-80-100-30-002	R852-80-xxx-30-002

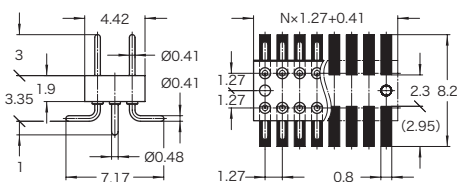


■2列の間隔が2.54mmのハーフピッチの表面実装ダブル・インライン・ピンコネクタで基板に対し垂直に実装されます ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

**R852...30-051シリーズ**

表面実装 2列  
ピン数 4~100 標準ピン数 100

メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	—	100ピン	任意のピン数 <sup>**</sup>
0.25 $\mu\text{m}$ 金	—	R852-10-050-30-051	R852-10-xxx-30-051
純錫	—	R852-80-050-30-051	R852-80-xxx-30-051



■R852...30-002シリーズの両端に位置決めピンが付いているタイプです ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン



# PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

## 一般仕様

動作温度範囲	-55~+125°C
耐候性分類(IEC)	55/125/21
動作湿度範囲(域)	年平均75%
最大定格電圧	AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ)

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。  
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

## 機械的特性

クリップ維持力	40N(最小、軸方向力適用では無変位)
コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力	3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2

## 電機的特性

隣接コンタクト間での絶縁抵抗値	10,000MΩ(最小、500Vacにて)				
隣接コンタクト間の静電容量	1pF(最大)				
隣接コンタクト間の沿面距離	3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm	80xシリーズ 0.85/0.7mm	83xシリーズ 0.5mm	85xシリーズ 0.4/0.5mm	86xシリーズ 0.5mm

環境特性 ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

乾熱試験	IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb	温度125°C, 16時間
湿熱試験	IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db	温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間
低温試験	IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A	温度-55°C, 2時間
熱ショック試験	IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na	温度-55/125°C, 5サイクル30分
振動(正弦)試験*	IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc	10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル
衝撃試験*	IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea	50g, 11ms, 3軸方向3衝撃
※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。		
ハンダ付性	J-STD-002A	Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7
ハンダ付耐熱性	J-STD-020C	260°C, 20秒
耐湿性	J-STD-020C	level 1
耐腐食性	1) 塩水噴霧試験	IEC 60068-2-11.Ka 48時間
	2) 二酸化硫黄ガス(SO2)試験	IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO <sub>2</sub> , 25°C, 75%RHで96時間
	3) 硫化ガス(H2S)試験	IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H <sub>2</sub> S, 25°C, 75%RHで96時間

無ハンダ対応プレスフィット特性 プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

挿入力	90N(最大)@最小穴直径/65N typ.
引抜き力	30N(最小)@最大穴直径/50N typ.
引抜き力 3サイクル時	20N(最小)@最大ホール直径
PCBホール寸法	2mmピッチ 仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm
	2.54mmピッチ 仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm0, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm
PCBホールメッキ	PCB表面処理 ホールメッキ
	錫 5-15µm錫(最小、25µm銅の上)
	銅 25µm(最小)
	金(ニッケル上) 0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル)

## 材質

シリーズ	右記以外	R830/R831/R832/R833	R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245
インシュレーター	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR
スリーブ	CuZn36Pb3(C36000)	CuZn36Pb3(C36000)	CuDn4Pb4Zn4(C54400)
コンタクト		ベリリウム銅(C17200)	

